



部品内蔵技術委員会主催 2025年度第一回公開研究会

主催：部品内蔵技術委員会

◆公開研究会のご案内

研究会テーマ「部品内蔵技術と高密度化を支える実装技術&材料」

エレクトロニクス実装学会部品内蔵技術委員会(委員長・加藤義尚:福岡大学)では、下記要領で2025年度第一回公開研究会を開催致します。今回は、部品内蔵技術に関する講演と、今後のエレクトロニクス実装技術において高密度化を支える技術&材料に関する講演の合計5件の講演となっています。是非、奮ってご参加下さい。

開催日時 2025年6月26日(木) 13:10~17:05

開催方式 現地開催 & WEB (Zoom Webinarシステム利用)ハイブリッド

開催場所 回路会館地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:10~13:15

オープニング

開会挨拶 部品内蔵技術委員会技術委員会

13:15~13:55

講演①「放熱樹脂を用いた部品内蔵基板およびビルドアップ基板の半導体チップ放熱検証」

株式会社メイコー 戸田 光昭 氏【現地講演】

<概要>古河電気工業株式会社様との共同研究において、新たに開発された熱伝導率1.7 (W/m・K)の放熱樹脂を部品内蔵基板の埋込樹脂およびビルドアップ基板の絶縁層樹脂に用いることにより半導体チップ放熱特性の向上が確認できた。また、日本高純度化学株式会社様との共同研究において、高周波特性におけるPA技術を用いたNiフリー無電解金めっきの優位性が確認できた。本発表では弊社の協調設計検証におけるこれらの取り組み事例を紹介する。

14:00~14:45

講演②「埋込性に優れた熱伝導性樹脂基板用材料開発とそれを用いた実装基板評価」

古河電気工業株式会社 徳久 憲司 氏【現地講演】

<概要>近年半導体デバイスの高機能化や高速化、パワーデバイスの高機能化や小型化にて放熱性が広く検討されている。樹脂基板ではフィラーを高充填とすると、基板配線間への樹脂充填、内蔵基板の部品埋込が困難となり、配線レイアウトに対しても様々な変更が起こる。放熱性を有しながら先の課題を改善し得る絶縁フィルムについてその諸物性並びに、銅箔積層基板と部品埋込基板を作製しその作製結果と実装評価結果について報告する。

14:50~15:20

講演③「狭小スペース向け薄型ペルチェ冷却モジュールと熱設計」

リンテック株式会社 大西 郷 氏【現地講演】

<概要>ペルチェモジュールは電子冷却デバイス的一种であり、応答性が高く電子機器の精密温度制御が実現できる。当社の開発モジュールは、独自の印刷工法で製造した薄膜熱電素子の搭載による薄型構造が特徴であり、高密度化する電子機器の温度制御に適する。開発モジュールの諸物性を紹介し、熱回路網法による解析から得られた知見をもとにした薄型設計特有の課題に対する取り組みについて報告する。

(休憩10分)

15:30~16:15

講演④ 「半導体の三次元積層に向けたRDL(再配線層)材料について」
太陽ホールディングス株式会社 緒方 寿幸 氏【WEB講演】

<概要>近年、ロジックやメモリのチップ間での微細配線による高密度接続が進むにつれて、半導体デバイスの高集積化に対する要求が高まっています。今後のサブミクロン配線微細化においては、半導体前工程の配線形成技術であるダマシンプロセスを後工程に転用することが期待されており、ネガ型感光性絶縁材料への開発要求が高まっています。本講演ではネガ型感光性絶縁材料のサブミクロン解像特性および絶縁信頼性について紹介します。

16:20~17:05

講演⑤ 「異方性導電膜(ACF)の最新開発動向と用途展開」
デクセリアルズ株式会社 大関 裕樹 氏【現地講演】

<概要>ディスプレイは狭額縁化・小型化・高精細化によるファインピッチ化が進行、それに伴う微細実装が必要とされています。技術トレンドにおける実装課題解決に向けた、デクセリアルズの異方性導電膜(ACF)最新の開発取り組みだけでなく、ACFの更なる用途展開についてご紹介します。

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定員 回路会館地下1F会議室:50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)
WEB (Zoom Webinar): 200名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:無料、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:15,000円、非会員学生:無料、協賛団体(JPCA会員):5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報をご連絡致します。
 - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:クレジットカード決済またはコンビニ決済のみ)(手数料学会負担)
 - ③領収書(宛名会社名選択可)のご発行は、返信メールのマイページから決済後に即日出力が可能です。
 - ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
 - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
- *キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info@jep.or.jp(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)